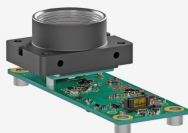


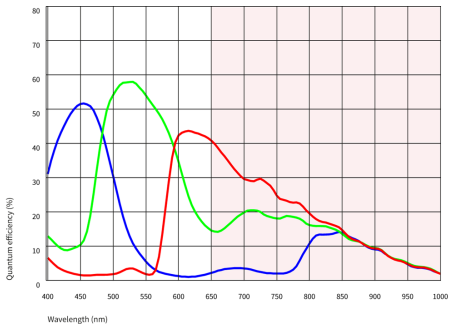
■ En serie
El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada.



Especificación

Sensor

Tipo de sensor	CMOS Color
Sistema de obturador	Global Shutter
Characteristic	Lineal
Clase de píxeles	8 MP
Resolución	8,13 Mpx
Resolución (h x v)	2856 x 2848 Pixel
Relación de aspecto	1:1
CAD	12 bit
Profundidad de color (caméra)	12 bit
Clase de sensor óptico	2/3"
Superficie optica	7,825 mm x 7,804 mm
Diagonal del sensor óptico	11,05 mm 2/3"
Tamaño de píxel	2,74 µm
CRA (Chief Ray Angle)	0 °
Fabricante	Sony
Denominación del sensor	IMX546-AAQJ-C
Ganancia (total/RGB)	16x/16x
AOI horizontal	misma frecuencia de imagen
AOI vertical	mayor frecuencia de imagen
AOI ancho de imagen / ancho de paso	256 / 2
AOI alto de imagen / ancho de paso	2 / 2
AOI cuadrícula de posición (horizontal/vertical)	2 / 2
Binning horizontal	-
Binning vertical	-
Método binning	Horizontal: Adición / Vertical: Adición
Factor binning	-
Decimation (subsampling) horizontal	mayor frecuencia de imagen
Decimation (subsampling) vertical	mayor frecuencia de imagen
Método Decimation (subsampling)	M/C automático



Modelo

Frecuencia de imagen en modo libre	48 fps
Frecuencia de imágenes disparador (continúa)	48 fps
Frecuencia de imágenes disparador (máxima)	48 fps
Tiempo de exposición (mínimo - máximo)	0,0094 ms - 2000 ms
Exposición larga (máxima)	120000 ms
Frecuencia de líneas en modo Freerun (barrido lineal)	1043 1/s
Frecuencia de líneas en modo de disparo (barrido lineal)	1051 1/s
Líneas por imagen (barrido lineal)	8000
Consumo de potencia	1,9 W - 3,9 W
Memoria gráfica	128 MB

Condiciones ambientales

Para versiones de placa tenga en cuenta las indicaciones específicas que figuran en la documentación pertinente.

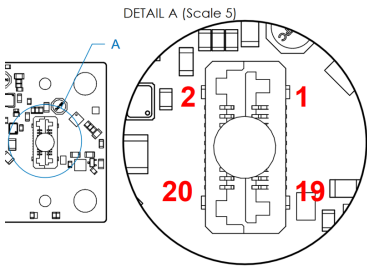
Temperatura del aparato permitida durante el funcionamiento	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
Temperatura del aparato permitida durante el almacenamiento	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Humedad (relativa, sin condensación)	20 % - 80 %

Conexiones

Conexión de interfaz	Samtec LSHM 20pol
Conexión I/O	Conector macho de 20 polos (Samtec LSHM-110-L02.5-L-DV-A-N-K-TR)
Alimentación	Cable USB

Asignación de pins conexión I/O

1	Tensión de alimentación de entrada (VCC), 5 V DC USB
2	No conectar (para utilizar más adelante)
3	Tensión de alimentación de entrada (VCC), 5 V DC USB
4	No conectar (para utilizar más adelante)
5	Datos USB 2 (-)
6	I2C SDA (Signal Data) 3,3 V
7	Datos USB 2 (+)
8	I2C SCL (Signal Clock) 3,3 V
9	Masa (GND)
10	Entrada de disparador sin optoacoplador 3,3 V
11	USB 3 TX (-)
12	Salida de flash sin optoacoplador 3,3 V 8 mA
13	USB 3 TX (+)
14	General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,3 V
15	Masa (GND)
16	General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,3 V
17	USB 3 RX (-)
18	No conectar (para utilizar más adelante)
19	USB 3 RX (+)
20	Tensión de alimentación de salida 5V (900 mA - la corriente de la cámara depende del sensor)



Diseño

Conexión del objetivo	Montura C
Grado de protección IP	-
Dimensiones	84,0 mm x 40,0 mm x 29,7 mm
Peso	41 g
Material de la carcasa	-

Features

Lista de funciones de preprocesamiento de imágenes integradas en la cámara.

Todas las funciones de la tabla están disponibles a través de nuestro software IDS peak para el preprocesamiento de imágenes en el ordenador host (según el modelo de sensor).

Adquisición de imágenes	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
Flash	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
Ajustes de imagen	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	✓
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
Procesamiento de imágenes integrado	Pixel formats	
	Mono8	
	BayerRG8	
	BayerRG10	
	BayerRG10p	
	BayerRG12	
	BayerRG12p	
	BGR8	
	RGB8	
	BGR10p32	
	RGB10p32	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
Otros	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	
	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	Events	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.6